

**Dk 3.31 Df 0.0023**  
**@14GHz**

**Tg(DSC) 200°C**

**T288(含铜)**  
**>120分钟**

## MEGTRON7

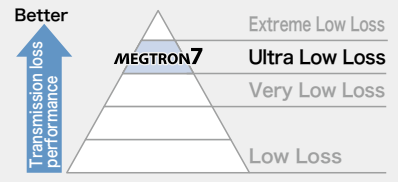
芯板  
**R-578Y(N)\* R-578Y(GN)\* R-578Y(GE)**

半固化片  
**R-568Y(N)\* R-568Y(GN)\* R-568Y(GE)**

\*低介电常数玻璃布类型

### 超低传输损耗·高耐热性多层基板材料

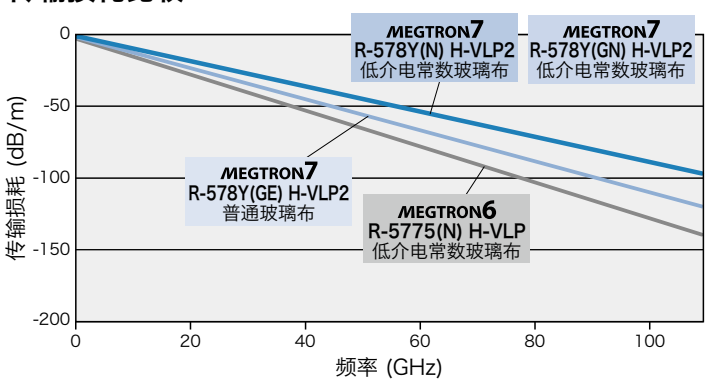
具备超低介电常数 / 介质损耗特性, 适用于高速大容量数据传输类高端服务器和路由产品。支持高多层, 超大尺寸 PCB 产品。



**应用**  
**网络/无线通信**

ICT 基础设施设备, 超级计算机, 测量仪器, 天线(基站、车载毫米波雷达)等

### 传输损耗比较



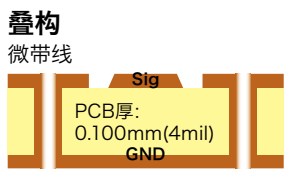
### 高多层耐热性

**结果**

孔径	φ0.3mm		
	通孔壁间距离	0.4mm	0.5mm
R-578Y(N) 低介电常数玻璃布 / H-VLP2	合格	合格	合格
R-578Y(GN) 低介电常数玻璃布 / H-VLP2	合格	合格	合格

**条件**  
260°C回流焊×20次

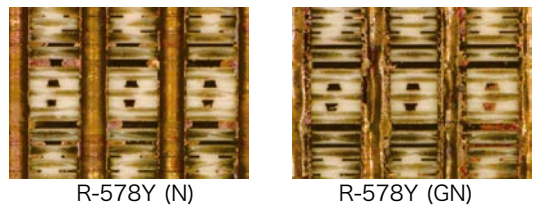
**叠构**  
32层  
板厚: 4.5mm



测定方法	2端口 S参数
测定频率	10MHz-110GHz
校正方法	TRL法
阻抗匹配	调整到 50Ω(Zo)

层1: 信号线层  
(线宽: 270μm、铜箔厚度: 24μm)

层2: GND平面层  
(铜箔厚度: 24μm)



### 一般特性

项目	试验方法	条件	单位	MEGTRON7 R-578Y(N)	MEGTRON7 R-578Y(GN)	MEGTRON7 R-578Y(GE)
				低介电常数玻璃布	低介电常数玻璃布	普通玻璃布
玻璃态转化温度(Tg)	DSC	A	°C	200	200	200
热膨胀系数(Z-轴方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	42	42	42
				280	280	280
T288(含铜)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分钟	>120	>120	>120
介电常数(Dk)	平衡型圆盘共振法	C-24/23/50	-	3.31 [14GHz]	3.31 [14GHz]	3.60 [13GHz]
介质损耗因数(Df)				0.0023 [14GHz]	0.0023 [14GHz]	0.0034 [13GHz]
铜箔剥离强度	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.8 [H-VLP]	0.8 [H-VLP2]	0.8 [H-VLP2]

试验片厚度为0.75mm。  
在使用本产品时, 请在我公司网站上确认注意事项。

上述数据为本公司测量所得的代表值, 非保证值。